

REFERÊNCIAS BÁSICAS

CÓD. PRODUTO: 578278

DESCRIÇÃO: test

Nº OP: 728

CLIENTE: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI

QTDE TOTAL OP: 2782

QTDE NPI: 2782

DATA: 2022-11-17

APRESENTAÇÃO DO NPI

Aplicação do Produto:

Classe (IPC-A-610):

Documentação está Ok : SIM

Falta o documento de:

Item possui revisão anterior: SIM

Qual cód.?

Origem do Stencil?

Data de chegada: 2022-11-17

Etiquetas do cliente? SIM

Quant. Etiquetas:

Tipo de Liga: Lead free

Instr. de Montagem Especial? SIM

Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo?

☐

Todos os cabos contêm suas especificações?

☐

Existem especificações e desenhos de montagem do produto?

☐

Existem especificações e desenhos de montagem do produto?

☐☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?

Etapas produtivas:

☐ SMT Bottom☐ Mont. PTH☐ Teste☐ OBA☐ SMT Top☐ Mont. Lean☐ ICT☐ Certificado de Qualidade☐ AOI☐ Verniz☐ Gravação☐ Registro de Histórico do Produto☐ Outros☒ Produtos Químicos (NOVO)

Ações de melhoria:

☐ desenvolver gabarito☐ recolher documentação☐ painelizar PCI☒ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional...)

Comentários quanto a apresentação do novo produto: cfescf

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO

Organizador (Eng. de Produto): Ana Paula Jahnz

Data: 2022-11-17

Participantes:

Eng. de Processo PTH: Celina Maximo Anouar

Eng. de Teste: Fernando Borges

Eng. de Processo SMT: João Ramiro

Comercial: Ana Carla Mendes

Eng. da Qualidade: ADRIANA FERREIRA

Outros: ADRIANA FERREIRA

REALIZAÇÃO DO NPI

ALMOXARIFADO

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2022-11-17

Atividade: Separação de materiais no almoxarifado

☒ Foi identificadodd alguma divergência de materiais?

☒ Algum componente será montado sob desvio?

Comentários quanto a apresentação do novo produto:
test

MONTAGEM SMT

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2022-11-17

Atividade: Printer

Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?



Tipo de insumo aplicado?

Tipo de apoio utilizado na Printer?

Inspeção por SPI?



Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?



Atividade: Inserção automática

Em qual linha foi realizado o NPI?

Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐

Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐**Atividade: Reflow e Inspeção**

Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"?

☐

Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:

Realizado inspeção visual?

☐

Utilizado Raio-X? *

☐**Atividade: Router**

Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI? BASE

Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐**VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)**

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2022-11-17

VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Placa 1 :

xqdq

Ok

xxzdq

Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: xzqdzq

Houve problemas críticos?

Gerado documento devido a problemas?

Verificação da Montagem SMT 1

Validado por: Nilson Ishikawa

Junto com: Nilson Ishikawa

MONTAGEM THT/LEAN

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN

Responsável: Wajdi Ben Helal

Data: 2022-11-17

Atividade: Pré forma

Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Cablagem

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Pré compor

Houve alguma dificuldade na depainelização?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Compor

Foi identificado algum problema durante a montagem?

☐

Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Soldar PTH/Inspeção

Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?

☐

A atividade de Touch up será necessário?

☐

O layout da placa facilita a operação de ressolda?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final

Todos os componentes contêm suas especificações?

☐

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?

☐

Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?

☐

Existe a aplicação de verniz no produto?

☐

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

☐

VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)

Responsável: Wajdi Ben Helal

Data:

VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Placa 1 :

xqdq

Ok

Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: xzqdqzxd

Houve problemas críticos? 1

Gerado documento devido a problemas? ☒

Doc.:

1

Validado por: Nilson Ishikawa

Junto com: Nilson Ishikawa

TESTES

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DO TESTE

Responsável: Wajdi Ben Helal

Data:

EXECUÇÃO DO TESTE

Qual tipo de teste é realizado?

Testes/Jiga desenvolvido por?

☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?

☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?

☒ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?

RESULTADOS DO TESTE

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2022-11-17

VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE

Seq. de Placas (número de série)

OK/FALHA

Descrição da Falha

Placa 1 :

xqdq

Ok

Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: xdzqx

EMBALAGEM

Run10 n°:

Responsável : Wajdi Ben Helal

Data: 2022-11-17

Atividade: Embalagem

☐ Há necessidade de etiqueta ESD?

☒ Comentários técnicos referente a etapa de Embalagem:

Qual tipo de embalagem será utilizado?

Como a embalagem será fechada?

REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)

Organizador (Eng. da Qualidade) : Ana Paula Jahnz

Data: 2022-11-17

Participantes:

Eng. de Processo PTH: Anna Paulla da Rocha

Eng. de Teste: ADRIANA FERREIRA

Eng. de Processo SMT: Aroilde Istailer Barbosa Souza

PCPM: Adriana F. de Lima Jeremias

Eng. de Produto: ADRIANA FERREIRA

Outros: Adriana F. de Lima Jeremias

ANÁLISE CRÍTICA:

Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças)

Wajdi Ben Helal

Data hora enviar : 2022-11-17 15:00:24

Data hora aprovada : 2022-11-17 15:01:54



PARECER FINAL STATUS

APROVADO

Com restrições? SIM

Implementação de: xdzqd

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de mudanças)

Novo Run10 é possível? *outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM

Wajdi Ben Helal



Data hora enviar : 2022-11-17 15:02:04

Data hora aprovada : 2022-11-17 15:02:16